

供抗热聚酰亚胺基材半导体晶片固定使用的双面胶

278

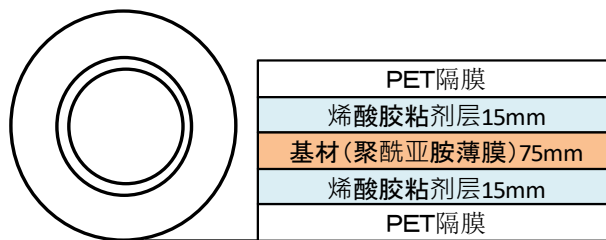
特征

- ①基于焊料耐热聚酰亚胺薄膜的耐热双面胶带
- ②在玻璃和半导体上具有出色的残胶性。
- ③为再剥离用途准许

用途

用于C-MOS相机模块的玻璃, 用于C-MOS的胶带

构造



特性

一般的特性

制品名	(基材厚度)	(粘着厚度)	粘着力
	(mm)	(mm)	(N/25mm)
278	0.105	0.015	5

测定条件	拉伸速度	300mm/min	
(JIS Z0237基准)	拉伸强度	180度	粘接后放置 1 小时的测量值
	测试温度	23°C	被粘物 SUS板

注意事项

- 技术资料是全部在共同技研化学株式会社的研究室进行的测试和实际测量值为基准制作的。
但是, 产品特性会根据环境和被体的不同而发生很大的变化。
因此, 这些特性数据是参考值, 并不是保证值。
在使用之前, 请确实使用这个产品适合使用用途和环境
- 以上数据为室温(23°C)下的数据。在低温下(5°C以下), 粘合强度可能会急剧下降。

保管注意事项

- 必须放在盒子里保管。
- 请勿在阳光直射的地方保管。
- 请勿将其暴露在高温、高湿的环境下。(温度30°C以上, 湿度50%以上严禁)。

共同技研化学有限公司
崎玉县所泽市南永井940牌号
3590011

Tel : +81 4 2944 5151

Mail : info-k@kgk-tape.co.jp

2020年5月22日 发行 URL : <https://www.kgk-tape.co.jp/>